

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 5 月 8 日 (08.05.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/037589 A1

(51) 国際特許分類⁷: B29B 11/12, B29C 33/58, H01L 21/56

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/11029

(22) 国際出願日: 2002 年 10 月 24 日 (24.10.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2001-332843
2001 年 10 月 30 日 (30.10.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 久保 勝己 (KUBO, Katsumi) [JP/JP]; 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪 1 7 7 2-1 日立化成工業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP). 稲川 節 (INAGAWA, Takashi) [JP/JP]; 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪 1 7 7 2-1 日立化成工業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP). 寺田 寛 (TERADA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪 1 7 7 2-1 日立化成工業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP). 小野 昭夫 (ONO, Akio) [JP/JP]; 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪 1 7 7 2-1 日立化成工業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP). 増淵 裕 (MASUBUCHI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪 1 7 7 2-1 日立化成工

業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP). 山田 建雄 (YAMADA, Tateo) [JP/JP]; 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪 1 7 7 2-1 日立化成工業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書
— 補正書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEALING MATERIAL TABLET, METHOD OF MANUFACTURING THE TABLET, AND ELECTRONIC COMPONENT DEVICE

(54) 発明の名称: 封止材タブレット、その製造方法及び電子部品装置

(57) Abstract: A method of manufacturing a sealing material tablet capable of reducing the adhesion of sealingly forming material onto the punching surface of a tablet forming machine, the sealing material tablet manufactured by the method, and an electronic component device having an element sealed by using the sealing material tablet, the method of manufacturing the sealing material tablet comprising the steps of feeding releasing agent molten in solvent onto the punching surface of the tablet forming machine, forming a releasing agent layer of more than 0.001 to less than 0.07 μ m in thickness on the punching surface, and feeding the sealingly forming material into the tablet forming machine; the sealing material tablet manufactured by the method or having a contact angle ratio of 1.15 to less than 1.35; the electronic component device comprising the element sealed by using the sealing material tablet.

[続葉有]



WO 03/037589 A1



(57) 要約:

タブレット成形機のパンチ面への封止用成形材料の付着の低減が図れる封止材タブレットの製造方法、この方法により製造された封止材タブレット及びこの封止材タブレットを用いて封止した素子を備えた電子部品装置を提供する。

溶剤に溶解した離型剤をタブレット成形機のパンチ面に供給して、前記パンチ面上に厚さが $0.001\mu\text{m}$ を超え $0.07\mu\text{m}$ 未満である離型剤層を形成させた後、封止用成形材料を前記タブレット成形機に供給して成形する封止材タブレットの製造方法、この方法により製造された又は接触角比が 1.15 以上 1.35 未満である封止材タブレット、及びこの封止材タブレットを用いて封止された素子を備えた電子部品装置。